

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 1月10日
【会社名】	東京応化工業株式会社
【英訳名】	TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 種市順昭
【本店の所在の場所】	川崎市中原区中丸子150番地
【電話番号】	044 (435) 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 平 康充
【最寄りの連絡場所】	川崎市中原区中丸子150番地
【電話番号】	044 (435) 3000 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 平 康充
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2023年1月10日開催の取締役会において、2023年3月1日を効力発生日として、当社の装置事業（一部を除きます。）（以下「対象事業」といいます。）を吸収分割により当社の完全子会社であるプロセス機器事業分割準備株式会社（以下「分割準備会社」といいます。）に対し承継すること（以下「本吸収分割」といいます。）を決議しておりますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1．本吸収分割の相手会社に関する事項

(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	プロセス機器事業分割準備株式会社
本店の所在地	川崎市中原区中丸子150番地
代表者の氏名	山本 浩貴
資本金の額	1円
純資産の額	1円
総資産の額	1円
事業の内容	半導体用・ディスプレイ用の製造装置などの各種プロセス機器の製造・販売

(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

分割準備会社の設立年月日は2022年12月16日であり、本臨時報告書提出日現在、最初の事業年度は終了しておりません。

(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

東京応化工業株式会社（提出会社） 100%

(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	本吸収分割の効力発生日に当社が分割準備会社の発行済株式の100%を保有いたしますが、同日付で当社が保有する分割準備会社の発行済株式の全てをAIメカテック株式会社（以下「AIメカテック」といいます。）に譲渡する予定です（以下「本株式譲渡」といいます。）。
人的関係	分割準備会社の取締役兼代表取締役には、当社の執行役員が就任します。
取引関係	記載すべき取引関係はありません。

2．本吸収分割の目的

当社は、1940年の設立以来、研究開発型企業として最先端技術を追求し、高純度化学薬品から感光性材料のフォトレジストの高機能化へと技術を拡大し、ファインケミカルの分野で事業を展開してまいりました。

この間、当社のコアコンピタンスである微細加工技術と高純度化技術を徹底的に磨き、競争環境の厳しい電子材料の業界において、当社は独自のM&E（Materials and Equipment）戦略によって、半導体用フォトレジスト、関連する高純度化学薬品等の高機能材料だけではなく、これらに関連する塗布装置、現像装置、灰化剥離装置等の製造装置を自社開発してきたことで競争力を維持・向上しており、係るM&E戦略の推進は今後も当社の競争力維持・向上に資するものであると考えております。

特に最近では、半導体業界の活況に伴い高機能材料が過去最高の売上高、営業利益をあげるとともに、装置事業においても、半導体用シリコン貫通電極形成プロセス等に使用されるウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン」が3次元実装市場の発展に伴い受注を伸ばしております。また、パワー半導体需要の拡大により、フォトレジスト灰化剥離装置であるプラズマアッシング装置の受注も増加基調で推移しております。

一方で、昨今の半導体製造装置業界においては、競争激化等を背景として技術革新のスピードが加速するなか、高度な専門性が求められ、ビジネスリソースや事業運営の合理化及び効率化が必要となっており、当社グループといたしましては、2030年のありたい姿である「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global

Company ” という経営ビジョンの下、収益力・キャッシュ創出力の強化を達成し企業価値の向上を図るため、事業の選択と集中を模索してまいりました。

係る状況下、当社は、経営資源を中核の材料事業に集中するため、本吸収分割及び本株式譲渡を通じて、対象事業を、微細塗布技術や高精度貼り合わせ技術をコア技術として、液晶パネル製造装置等の開発、設計、製造、販売、アフターサービスを国内外で展開し、高度な技術力と顧客サポート力を備えた装置メーカーであるAIメカテックに譲渡

するとともに、当社の材料事業とAIメカテックに譲渡後の対象事業の協業を行うことで、対象事業の強化及び持続的成長、並びに、当社のM&E戦略の維持及び更なる発展が期待されると考えたことから、本吸収分割及び本株式譲渡を行うことを決定いたしました。

(注)「e-Material」とは「Electronic material (電子材料)」のことをいいます。

3. 本吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1) 本吸収分割の方法

当社を分割会社とし、分割準備会社を承継会社とする吸収分割です。

(2) 吸収分割に係る割当ての内容

当社は本吸収分割に際して、株式の割当てその他の対価の交付を行いません。

(3) その他の本吸収分割契約の内容

承継する権利義務

分割準備会社は、本吸収分割に際して、当社の営む対象事業に関して有する権利義務を吸収分割契約において定める範囲において承継します。

日程

取締役会決議日	2023年 1月10日
本吸収分割契約締結日	2023年 1月10日
本吸収分割効力発生日	2023年 3月 1日

4. 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

5. 本吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	AIメカテック株式会社 (本株式譲渡の効力発生後、2023年3月1日付で分割準備会社を吸収合併により承継予定)
本店の所在地	茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地
代表者の氏名	代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄
資本金の額	450百万円
純資産の額	7,680百万円(2022年6月30日現在)
総資産の額	18,468百万円(2022年6月30日現在)
事業の内容	電子部品製造装置、周辺機器の設計・製造・販売及びアフターサービス

以 上